东南大学与华润上华共同签订联合实验室合作意向书

2004-12-21

(2004 年 12 月 21 日) 东南大学 IC 学院无锡分院、东南大学国家 ASIC 中心无锡研发中心揭牌仪式于今日在东南大学无锡分校隆重举行。东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心无锡研发中心（后简称“ 东南大学 ”）与无锡华润上华半导体有限公司（后简称“ 华润上华 ”）在仪式中同时签署 “ 联合实验室合作意向书 ”，为无锡地区 IC 产业的产学研合作揭开新的篇章。

东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心主任时龙兴和华润上华总经理李乃义代表双方在“ 联合实验室合作意向书 ”签字。透过此项合作，华润上华将为东南大学无锡研发中心提供人才培养所需的生产实习和研发实验条件，东南大学将为双方所需的人才进行技术培训。藉由积极的产学研合作，将更进一步培养技术研发人才，为无锡 IC 产业发展注入新的活力。

华润上华总经理李乃义表示：“ 华润上华自 1997 年成立以来，一直以推动中国半导体产业的发展为己任。我们将持续与国内 IC 学院及研究单位合作，促进中国 IC 产业的产学研交流。也希望此次合作能起一个抛砖引玉的作用，我们乐见未来有更多产学研项目在无锡发展，共同打造无锡为中国半导体产业重镇。 ”

出席揭牌仪式的有中国工程院院士、东南大学校长顾冠群教授，中共无锡市委书记杨卫泽，无锡市副市长谈学明和东南大学副校长邹采荣。

关于华润上华科技有限公司 (CSMC Technologies Corporation)

作为中国主流晶圆专工业之先锋，华润上华为专业的 IC 设计公司（Fabless design house）及器件整合生产商(IDMs)提供了集成电路制造、晶圆代工管理和营运服务。华润上华的晶圆一厂成立于 1997 年，是中国第一家纯晶圆专业代工厂，也是中国最大的晶圆代工厂之一。晶圆一厂专注于逻辑电路、混合信号、高压和非挥发性记忆 IC，提供高品质和高成本效益的代工服务，拥有最小线宽 0.35 微米的制程技术。华润上华的总部位于中国无锡，在台湾和香港等地设有办事处。欲了解更多的相关信息，请访问网站 www.csmc.com.cn。

发稿日期:2004 年 12 月 21 日

新闻联系人:
华润上华公共关系部 李静娟
Tel: +86 510 586 1988 ext. 2287
Fax: +86 510 587 7352
Mobile:13771112291
Email: cecilia@csmc.com.cn